

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日交流）
参与单位名称及人员姓名	参加全景网 2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2023年11月15日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长沈庆芳 独立董事张建军 副总兼财务总监萧得望 副总兼董秘周红
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2023年11月15日通过全景网络提供的网上平台参与2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动。本次活动问答环节内容如下： Q：董秘好，公司近期在非大客户的业务方面新的订单斩获情况如何？

答：公司持续服务国内外众多领先品牌客户，具备为不同客户提供全方位PCB电子互联产品及服务的强大实力，国内、国外的知名品牌厂商均为公司客户。在产品方面，近年来公司不断开发新产品、新技术，在保持通讯产品和消费电子行业优势同时，加快布局AR/VR、AI服务器及智能汽车市场。在AR/VR领域，公司通过与全球领先的品牌厂商合作，已成为国内外主流产品的供应商。在汽车领域，公司应用于电池模块的FPC类产品、雷达运算板、域控制器产品已经量产供货，激光雷达板已有技术储备并开始样品认证。在服务器领域，面对新兴的AI服务器需求成长，公司在技术上持续提升厚板HDI能力，目前已切入全球知名服务器客户供应链。谢谢！

Q：沈董好，公司在交换机服务器类和车用类产品的营收增长空间如何？预期能否保持年均双位数增长？

答：近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的大爆发。根据Prismark数据，2022年至2027年，服务器及存储设备领域、汽车领域PCB产品分别以7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。PCB是整个电子产业链的基础元器件，为把握市场机遇，公司进行了高阶HDI/SLP及汽车板/服务器等项目的投入建设，潜心打造PCB领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。谢谢！

Q：你好，请问这股的融券从哪儿融的？您认为融券对这股股价有影响没？

答：融资融券标的由交易所根据相关规定选定，具体融券业务请咨询交易券商。股价的波动受许多因素的影响，公司运营状况正常，同时公司将通过持续创新，不断提升技术水平与产品开发能力，保持与世界一流客户的合作，不断加强公司在PCB领域的竞争力与市场地位，并积极拓展新的领域，保持公司的可持续发展。公司还通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司。谢谢！

Q：请问沈董，在合规情况下，您能否大概讲一讲在折叠屏和AR/VR等产品逐渐起量的消费趋势下，对于公司的软板或类载板产品有什么样的机会？公司产品是否已导入相关客户？以及销量和价格提升空间大概是什么情况？

答：PCB是电子产品关键互连件，不仅为电子元器件提供电路连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备。对于折叠屏产品，薄型化是确定的发展趋势，由此，给软板及类载板产品会带来新的发展空间。同时，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及AR/VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。此外，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的爆发。在此背景下，对下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求。面对新一代信息技术的发展，公司将充分发挥自身

优势，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，不断获取新的发展动能。

Q: 沈董 我是一个鹏鼎的小长期投资者。毋须讳言一年来公司的股价也反映了资本市场对公司在经营上的一些方面并不认可，这对公司也有很严重的影响，比如本次公司推出的定向募集计划的搁浅，我相信公司也在募集的过程中和潜在的投资方有这方面的沟通。请问沈董在沟通的过程中双方主要的分歧表现在哪些方面？公司具体在这些方面是否会做出改进以重新赢得投资者的信任。谢谢

答:感谢您对公司的关注。公司再融资撤回，主要是综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司主动向深交所申请撤回本次发行申请文件，不存在与潜在投资方发生分歧的情况。公司非常重视与投资者交流，在保证合规的前提下，公司一直秉持积极态度通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等多种方式让市场及时、全面的了解公司。

Q: 鹏鼎股价持续3年下跌，而跟pcb整个板块走势完全不一样，像沪电、东山等pcb公司3年股价都是稳定上升，而鹏鼎股价从60跌到20块钱，对于投资者来说，有很大的心里打击。而最近贵公司北向资金持续减仓，还有贵公司大股东德乐投资公司疯狂减持，对于投资者利益有很大的损害，而贵公司缺没有任何的处理方案，那未来贵公司还适合投资者持续投资么

答:股价的波动受许多因素的影响，公司运营状况正常，近期我们也公告了回购计划，公司计划用2-4亿现金回购股份，用于员工持股或股权激励。这代表了公司对自身价值的认可，也是对未来发展的信心。同时公司将通

过持续创新,不断提升技术水平与产品开发能力,保持与世界一流客户的合作,不断加强公司在PCB领域的核心竞争力与市场地位,并积极拓展新的领域,保持公司的可持续发展。公司还通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司。谢谢!

Q: 董秘好,可否提一个小小建议,投资者交流深度能否参考立讯精密?在合规情况下,尽量提高内容深度而非泛泛予以回复,以便投资者能更好的了解公司发展现状和前景。

答:感谢您的建议。公司重视与投资者的交流,将在合规的前提下不断精进及提高与投资者交流深度,做好投资者关系工作。谢谢!

Q: 董秘好,公司的产品是否已运用到低轨卫星等硬件部署中?

答:公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造与销售服务的专业大型厂商,主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等,主要客户包括通讯电子领域客户、消费电子及计算机领域客户以及汽车电子和AI服务器、高速计算机等领域客户,暂不涉及低轨卫星等领域。谢谢!

Q: 沈董您好!臻鼎控股在2023年3季度业绩成果简报中提到,臻鼎未来五年伺服器和车载板复合成长率均达双位数,请问鹏鼎在这种增长机遇中扮演何种角色?臻鼎如何在鹏鼎、礼鼎、先丰三大运营主体进行分工?这种分工如何平衡“规避同业竞争”与“鹏鼎控股拓展发展空间、把握结构性增长机会”的关系?您同时作为臻鼎和鹏鼎的董事长,如何平衡臻鼎的利益和鹏鼎中小股东的利益?

答：您好！臻鼎为鹏鼎间接控股股东，间接持有鹏鼎71.83%的股权，中国大陆PCB相关业务均在鹏鼎旗下，目前经合并报表，鹏鼎业务收入占臻鼎收入的90%以上。汽车和服务器相关产品是鹏鼎近年来积极布局的领域，从产品布局来看，鹏鼎在汽车电子领域硬板主要聚焦于自动驾驶及智能驾舱的域控制器板等，由于智能驾驶水平不断提升而使电路板不断向高阶HDI需求转换的领域，同时在其他感知层类产品，如毫米波雷达等，将主要聚焦在高速运算板，在软板方面，鹏鼎将聚焦电池板，显示及摄像板等相关领域。在服务器领域，鹏鼎产品主要聚焦于HDI叠构的厚板。先丰通讯系中国台湾车用雷达板制造商，主要产品聚焦高频毫米波雷达天线板，其主要产品与公司产品应用于不同的下游领域。礼鼎主要产品是IC载板，与鹏鼎不涉及同业竞争。公司持续看好未来服务器与车载板市场，目前相关产品已在淮安第一园区批量供货，泰国园区相关产品生产线也在筹建中。未来，公司也将依据相关法律法规，积极采取各项措施规避同业竞争，保护中小股东利益。

Q：沈董好，公司营收已经是多年行业排名第一，估值却始终行业倒数，很多个人投资者和机构都对于公司后续的成长性持有怀疑态度，请问沈董及公司管理层对于投资者关心的问题能否做下简单的说明？

答：感谢您的建议！PCB是电子产品关键互连件，不仅为电子元器件提供电路连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备。近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及AR/VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代

	<p>表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的爆发。在此背景下，对下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求。面对新一代信息技术的发展，公司将充分发挥自身优势，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，不断获取新的发展动能。公司也将积极通过接待投资者线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司，传递公司发展战略及市场价值。</p> <p>交流过程中，公司严格按照有关制度规定，无未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月15日